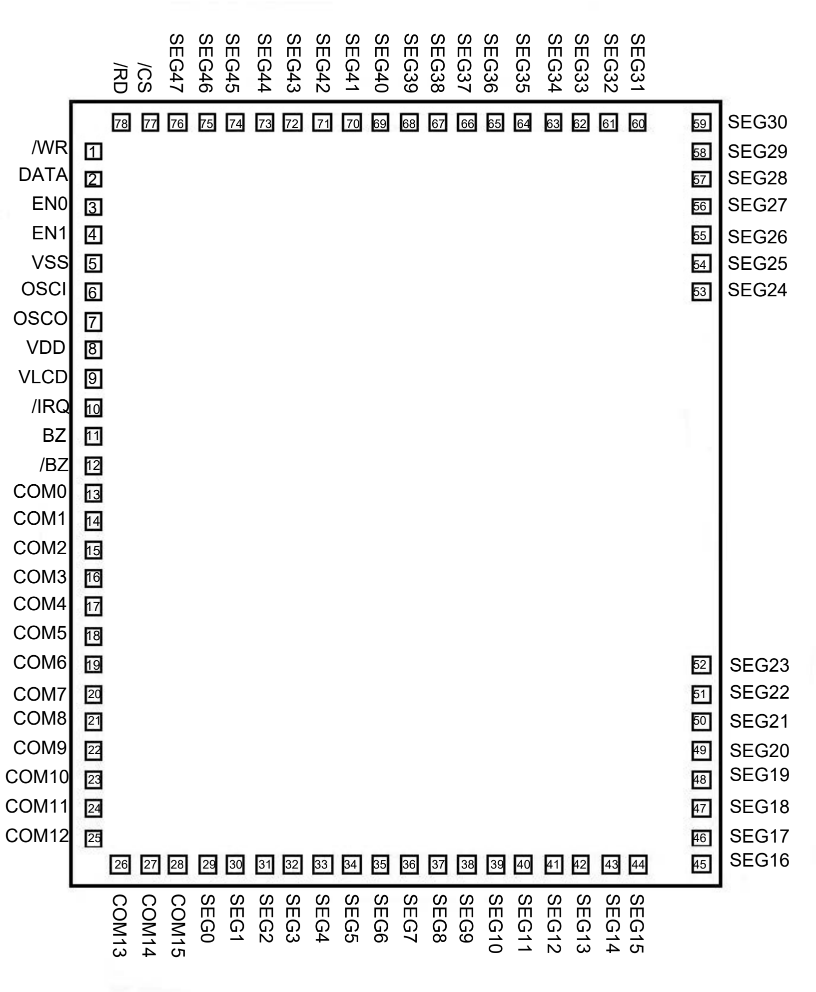
VK1626 COB资料

COBPAD图



衬底电位：VDD

PAD 大小：90×90 um，间距：112 um，铝垫大小：100×100 um，铝垫厚度：1um

COB PAD坐标

（坐标原点在芯片中心，单位：μm）

序号	名称	X坐标	Y坐标	序号	名称	X坐标	Y坐标
1	/WR	75.8	3210	40	SEG11	1961.15	74.65
2	DATA	75.8	3085	41	SEG12	2086.15	74.65
3	EN0	75.8	2960	42	SEG13	2211.15	74.65
4	EN1	75.8	2835	43	SEG14	2336.15	74.65
5	VSS	75.8	2710	44	SEG15	2461.15	74.65
6	VSCI	75.8	2585	45	SEG16	2694.2	74.65
7	OSCO	75.8	2460	46	SEG17	2694.2	199.65
8	VDD	75.8	2335	47	SEG18	2694.2	324.65
9	VLCD	75.8	2210	48	SEG19	2694.2	449.65
10	/IRQ	75.8	2085	49	SEG20	2694.2	574.65
11	BZ	75.8	1960	50	SEG21	2694.2	699.65
12	/BZ	75.8	1835	51	SEG22	2694.2	824.65
13	COM0	75.8	1710	52	SEG23	2694.2	949.64
14	COM1	75.8	1585	53	SEG24	2694.2	2595.35
15	COM2	75.8	1460	54	SEG25	2694.2	2720.35
16	COM3	75.8	1335	55	SEG26	2694.2	2845.35
17	COM4	75.8	1210	56	SEG27	2694.2	2970.35
18	COM5	75.8	1085	57	SEG28	2694.2	3095.35
19	COM6	75.8	960	58	SEG29	2694.2	3220.35
20	COM7	75.8	835	59	SEG30	2694.2	3345.35
21	COM8	75.8	710	60	SEG31	2461.15	3345.35
22	COM9	75.8	585	61	SEG32	2336.15	3345.35
23	COM10	75.8	460	62	SEG33	2211.15	3345.35
24	COM11	75.8	335	63	SEG34	2086.15	3345.35
25	COM12	75.8	210	64	SEG35	1961.15	3345.35
26	COM13	211.15	74.65	65	SEG36	1835.15	3345.35
27	COM14	336.15	74.65	66	SEG37	1711.15	3345.35

序号	名称	X坐标	Y坐标	序号	名称	X坐标	Y坐标
28	COM15	461.15	74.65	67	SEG38	1586.15	3345.35
29	SEG0	586.15	74.65	68	SEG39	1461.15	3345.35
30	SEG1	711.15	74.65	69	SEG40	1336.16	3345.35
31	SEG2	836.15	74.65	70	SEG41	1211.15	3345.35
32	SEG3	961.15	74.65	71	SEG42	1086.15	3345.35
33	SEG4	1086.15	74.65	72	SEG43	961.15	3345.35
34	SEG5	1211.15	74.65	73	SEG44	836.15	3345.35
35	SEG6	1336.15	74.65	74	SEG45	711.15	3345.35
36	SEG7	1461.15	74.65	75	SEG46	568.15	3345.35
37	SEG8	1586.15	74.65	76	SEG47	461.15	3345.35
38	SEG9	1711.15	74.65	77	/CS	336.15	3345.35
39	SEG10	1836.15.	74.65	78	/RD	211.15	3345.35